

高密度実装HPCサーバー

HPC5000-XIL2UTwin

第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを搭載
2U筐体に2ノードを収納した高密度実装HPCサーバー



特 長

- インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを1筐体に4CPU(最大160コア)搭載可能
- 最大2TBメモリ搭載可能
- 1ノードあたり最大12台の2.5型U.3 SSDを搭載可能
- 高密度実装でありながら十分な拡張性を確保
- IPMI2.0が高度な遠隔監視、操作を実現
- 冗長化電源搭載による高い障害耐性



製品仕様

インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサを1筐体に
4CPU(最大160コア)搭載可能

HPC5000-XIL2UTwinは、2U サイズのラックマウント筐体に2 ノード収納した省スペースサーバー。10nm 世代の最新CPU、インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを 1 ノードあたり2CPU (80 コア) 搭載可能です。1 筐体で 2 ノードのクラスター計算機を構成することができます。

最大2TBメモリ搭載可能

HPC5000-XIL2UTwinは、DDR4-3200対応メモリスロットを16本搭載しており、128GBメモリモジュールを使用する事で最大2TBのメモリ容量を確保します。メモリ性能を必要とする大規模な計算でパフォーマンスを発揮します。

1ノードあたり最大12台の2.5型U.3 SSDを搭載可能

HPC5000-XIL2UTwinは、1ノードあたり最大12台の2.5型U.3 SSD/SATA SSDを搭載可能です。HDD/SSDは前面からアクセスできるホットスワップエンクロージャに収納され、レバー操作で交換が可能であるため、メインテナンス作業が容易に行えます。

高密度実装でありながら充分な拡張性を確保

HPC5000-XIL2UTwinは、AIOM(Advanced I/O Module)と呼ばれるI/Oモジュールを、用途に合わせてノード毎に柔軟に組み合わせて搭載することが可能です。AIOM には、1/10/25(SFP28) Gigabit Ethernet 等がラインナップされています。

冗長化電源搭載による高い障害耐性

HPC5000-XIL2UTwinは、100Vから200Vに対応した2200W電源ユニットを2個搭載し、一方の電源ユニットに障害が発生した場合でもサーバーの運転を継続するための電力を十分に供給できる冗長性を持っています。これにより万が一の電源ユニット障害によるダウンタイムを最小限に抑えることが出来ます。

高い変換効率を誇る80PLUS TITANIUM認証取得を搭載

HPC5000-XIL2UTwinは、80PLUS TITANIUM認証を取得した高効率な電源を採用しています。80PLUS認証とは、交流から直流への変換効率を保証するものです。80PLUS TITANIUM認証は、負荷率10%/20% /50% /100%でそれぞれ90%/92% /94% /90%という高い変換効率基準をクリアしたものに与えられます。

IPMI2.0が高度な遠隔監視、操作を実現

標準搭載されたIPMI2.0機能は専用のLANポートを備え、リモートによる温度、電力、ファンの動作、CPUエラー、メモリエラーの監視を可能にします。また、電源のオンオフ、コンソール操作を遠隔から行うことができます。これらの機能によりシステムの信頼性、可用性を高め、ダウンタイムとメインテナンス費用を圧縮することを可能にします。

OS	AlmaLinux 8 x86_64 Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64 ※ Windows OS を希望される場合は、別途ご相談ください。
プロセッサ	第3世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ ※搭載不可能な CPU が一部ありますので、詳細につきましては別途お問い合わせください。 なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。
プロセッサ搭載数 (per node)	最大 2CPU(最大 80 コア、最大 TDP540W)
プロセッサ冷却方式	空冷式
チップセット	インテル® C621A
メモ per node	2TB (128GB DDR4-3200 ECC Registered × 16) 1TB (64GB DDR4-3200 ECC Registered × 16) 512GB (32GB DDR4-3200 ECC Registered × 16) 256GB (16GB DDR4-3200 ECC Registered × 16) 128GB (8GB DDR4-3200 ECC Registered × 16)
メモリモジュール	16DIMM スロット / node DDR4-3200 ECC Registered (8,16,32,64,128GB)
内蔵ストレージ per node	標準 : 960GB (2.5 型 , SATA SSD) × 2 2.5 型 最大 12 台 (U.3/ SATA SSD)
内蔵ストレージ最大容量 per node	92.16TB(7.68TB SATA SSD × 12) 184.32TB(15.36TB U.3 × 12)
光学ドライブ per node	なし
グラフィックス per node	Asped AST2600
インターフェイス per node	VGA [D-sub15ピン] (背面) × 1 ※ビデオカード搭載時は出力機能を OFF に設定します。 USB3.0 (背面) × 2 IPMI2.0 ポート [RJ45] (背面) × 1 ※最低 1 枚のネットワークカード (AIOM) をバンドルする必要があります。お問い合わせください。
拡張スロット per node	PCI-Express 4.0 (x16) × 1 , PCI-Express 4.0 (x8) × 2
電源ユニット	2200W × 2 (80PLUS TITANIUM 認証取得) 100V 環境 1200W × 2 200V 環境 1800W × 2
AC ケーブル	100V 用 AC ケーブルを 2 本添付 (IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P)
AC コネクタタイプ	IEC 320-C14
最大消費電力	2200W
筐体タイプ	ラックマウントタイプ (2U)
サイズ (縦幅×横幅×奥行)	88mm × 449mm × 730mm
重量	Net Weight:24.7 kg/Gross Weight: 38.6 kg
付属品	100V 用 AC ケーブル × 2 USB キーボード (日本語または英語) × 1 USB 光学式スクロールマウス × 1 取扱説明書 保証書
保証	3 年間センドバック保守

販売店



HPCシステムズ株式会社

〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階

TEL:03-5446-5531 FAX:03-5446-5550

Mail:hpcs_sales@hpc.co.jp

■ この内容は、2022年03月03日現在の内容です。

■ 価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。商品の色調は実際と異なる場合があります。

■ 社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

■ Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。

